



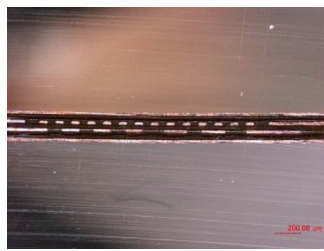
# CCF<sup>®</sup>-200 Series

## 液状層間絶縁材料

### Liquid Dielectrics Material

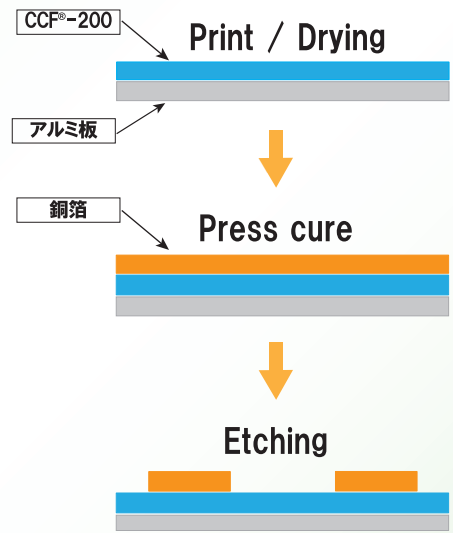
#### MCCL 用途タイプ

- **安定した密着強度** Steady strong adhesion  
FR-4, ポリイミドフィルム, 銅箔, アルミ板  
FR-4, Polyimide film, Copper foil, Aluminum sheet
- **高耐熱性** Excellent heat resistance
- **スクリーン印刷対応 低レジンフロー**  
Screen-printing type, Low resin flow



フレキの使用例 Using FLEX Type

#### CCF<sup>®</sup>-200 の使用例



CCF <sup>®</sup> -200 Series				MCCL Type	FLEX Type
ガラス転移点	Tg	*TMA method	℃	115	82
線膨張係数	CTE	α 1	ppm	68	102
弾性率	Young's modulus		GPa	2.3	1.6
破壊強度	Tensile strength		MPa	68	40
破壊伸び率	Elongation		%	6.7	19
ピール強度	Peel strength		N/cm	On Copper foil Above 12	On Polyimide Above 8
絶縁強度	Dielectric strength		kV/mil	5.2	3.1
レジンフロー	Total resin flow		μm		<150
燃焼試験	Flammability test			V-0	V-0
はんだ耐性	Solder resistance	@288℃ (sec.)		>1800	10sec. 10cycles
PCT 耐性		120hr		No delamination	No delamination
折曲試験	Bending Test	mm φ		6	2